

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2024-043

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于全资子公司竞买深汕合作区地块的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易情况概述

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟竞买深汕合作区地块的议案》，同意公司全资子公司深圳瑞华泰应用材料科技有限公司（以下简称“瑞华泰应用”）竞买位于深圳市深汕合作区鹅埠街道（规划绿宝路与产业路交汇处东北侧）建设用地 E2024-0004 宗地，地块占地面积 83,617 平方米，约折合 125 亩（以实际出让面积为准）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于全资子公司拟竞买深汕合作区地块的公告》（公告编号：2024-042）。

二、交易进展情况

近日，瑞华泰应用按照法定程序参与了深圳市规划和自然资源局深汕管理局发布的国有土地使用权挂牌出让活动，以人民币 3,030 万元竞拍取得了国有建设用地使用权（宗地编号：E2024-0004），并与深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签订了《成交确认书》（深土交成 2024〔42〕号），后续将与相关部门签署《深圳市国有建设用地使用权出让合同》等相关文件，办理权证相关事项。

本次交易事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已履行必要的审批程序。

三、竞拍土地使用权基本情况

- 1、出让方：深圳市规划和自然资源局深汕管理局
- 2、竞得人：深圳瑞华泰应用材料科技有限公司
- 3、土地位置：深圳市深汕合作区鹅埠街道（规划绿宝路与产业路交汇处东北侧）
- 4、地块名称：E2024-0004 宗地
- 5、土地用途：工业用地
- 6、出让面积：83,617 平方米
- 7、出让年限：30 年
- 8、出让价款：人民币 3,030 万元

四、本次购买土地使用权对上市公司的影响

公司现有厂址位于深圳市宝安区松岗街道华美工业园内，占地面积 52 亩，空间较小，且周边规划已陆续向非工业用途转变，无可供企业发展的余量土地供应，对公司松岗厂区的发展和布局亦存在不确定性影响。

本次购买该土地使用权，未来将重点围绕柔性光电用 PI 及 CPI 材料、集成电路与半导体封装用 PI 材料、低轨卫星耐氧原子 PI 材料、新能源应用功能聚酰亚胺材料等产业化方向布局。对于公司未来扩大规模和长远发展具有积极作用，能够增强公司未来的可持续发展和盈利能力，保障公司在深发展的连续性和稳定性，符合实际需要，符合公司和股东的长远利益。

本次参与竞买资金来源于公司自有资金或自筹资金，预计短期内不会对公司财务及经营状况产生较大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次公司竞得土地使用权尚需签署土地出让合同，并办理相应权属证书等工作，可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素影响，存在一定的不确定性。

公司后续将根据本次事项的进展情况，按照《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意风险，谨慎投资。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2024年12月4日